

Lasertec News 17

株 主 通 信 第 5 5 期 (2016年7月1日～2017年6月30日)

新中期経営計画フェーズⅡの達成に向け、
順調に推移



Lasertec

証券コード6920



2017年6月期(当期)は、売上、利益、受注、受注残、すべての面で過去最高の成績を達成し、将来の大きな成長に向けて基礎を築いた一年でした。

レーザーテック株式会社 代表取締役社長

岡林 理

Q 1 当期の業績についてどう評価されますか。市場環境と併せてお話しください。

A 1 好調な市場環境にも恵まれ、売上、利益ともに過去最高の業績を達成できました。

当社の主要販売先である半導体業界では、IoT(さまざまなモノ(物)がインターネットにつながる)やAI(人工知能)の進展、データサーバーの需要の高まりなどから、メモリーメーカーにおける3D-NAND向け投資が活発になり、大手ファウンドリも10nmノードなど微細化のための先端設備投資を高い水準で継続しました。

このような環境下、当社は大手ファウンドリ向けを中心に、特に半導体フォトマスク欠陥検査装置が過去最大の受注獲得に成功し、

連結業績ハイライト



当期の好業績へとつながりました。

当期の業績は、売上高173億69百万円(前連結会計年度比13.6%増)、営業利益49億60百万

円(同12.0%増)、経常利益49億89百万円(同9.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益35億54百万円(同10.1%増)となりました。

Q 2 当期は新中期経営計画フェーズⅡの2年目でした。
今期(2018年6月期)はいよいよフェーズⅡの最終年度となります。進捗状況はいかがですか？

A 2 コアビジネスのさらなる強化と新規事業の拡大を進めた結果、当期の受注額は254億10百万円に達し、当期末受注残は過去最高の182億53百万円をもって今期に入ることができました。
フェーズⅡの計画達成に確かな手ごたえを感じています。

半導体マスク欠陥検査装置 MATRICESにおいて、最先端の10nm～7nmノードに対応したモデル X810EXを2016年に市場投入し、受注面でも売上・利益面でも当期業績に大きく貢献しました。当モデルを中心とした半導体マスク欠陥検査装置が今期も引き続き業績を牽引していくと見込まれます。

FPD(フラットパネルディスプレイ)関連では、旧ラインの生産停止によるLCD(液晶)パネルの生産調整が進捗し、足元のパネル需給環境に改善がみられました。今期はLCDから有機ELパネルへの移行のための投資が継続し、10.5世代と呼ばれる大型パネル向けの投資も本格化すると予想されることから、

この設備投資拡大の好機を逃さず、FPD フォトマスク欠陥検査装置 CLIOS の受注・売上の増加を図ります。

新規事業の半導体ウェハ検査関連では、2015年9月に発表したSiC ウェハ欠陥検査/レビュー装置の新モデル SICA88 が好評を博し、高いマーケットシェアを獲得できました。その他の半導体ウェハ検査関連製品でも新規のお客さまでの採用が進んでおり、新規事業の基盤づくりが順調に進んでいます。

また、新しい露光技術である EUVL (extreme

ultraviolet lithography: 極端紫外線リソグラフィ) への対応では、当期に露光波長と同じ 13.5nm の光源を用いた EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS を発表いたしました。当社は EUVL に対応する製品として、EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS、マスク欠陥検査装置 MATRICS (EUV オプション)、EUV マスク裏面検査/クリーニング装置 BASIC の 3 製品をラインアップし、2019 年頃と言われている EUVL の量産適用に向けた積極的な営業活動を推し進めています。

Q 3 IoT や AI の進展から、半導体産業が新たな成長ステージに入ったという話を聞きます。今後の半導体産業の成長に関する考えをお聞かせください。

A 3 多少の景気の変動はあるにせよ、半導体産業の長期的な成長は続きます。その成長を支える一大生産拠点になろうとしているのが中国です。

さまざまな機器がインターネットでつながり、各種機器の情報やセンサで取得したデータが巨大データセンターに保存、蓄積される時代が到来しています。AI を進化させるディープラーニング (深層学習、機械学習の一種) と呼ばれる手法が主流になってくると、より正確な学習を行うために、より膨大なデータの収集が必要となり、そのビッグデータを高速で分析処理するプロセッサも必要となります。IoT では莫大な量の通信デバイスやセンサが使われ、集められたデータを保存するデータセンターでは膨大な量のメモリーやプロセッサが使われます。これらすべてが半導体または半導体の技術を用いて作られたものです。

現在の半導体の主な用途であるパソコンやスマー

トフォンでも半導体の使用量は年々増加していますが、これらに加えて IoT や AI などの新しい用途の拡大によって、半導体の使用量は将来にわたって加速度的に増大していくことが見込まれます。さらに EV (電気自動車) 化や自動運転の進展は、自動車産業における半導体やセンサの使用量を飛躍的に増加させます。これらのトレンドを踏まえ、半導体産業の長期的な成長は続くと確信しています。

この成長する半導体産業の一大生産拠点になろうとしているのが中国です。SEMI (エレクトロニクス製造サプライチェーンの国際工業会) の 2017 年 7 月の予測では、2018 年に中国が韓国に次いで世界で 2 番目に大きな半導体製造装置 (検査・計測装置含む) の市場になる見通しです。中国政府

の後押しもあり、その後も大きな成長が見込まれていることから、同国でのサポート体制を一層強化するため、当社は2017年6月、上海に現地法人

を設立しました。今後中国におけるサポート拠点を順次拡充していきます。

Q 4 配当方針を一部変更されましたが、どのような変更でしょうか？

A 4 今期より中間配当を実施します。

当社は株主の皆さまへの利益還元の機会を充実させるため、剰余金の配当を期末配当として年1回実施する方針から、中間配当と期末配当の年2回実施する方針に変更しました。中間配当は今期より実施する予定です。なお、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会が配当の決定

機関となっています。

なお、安定的な利益還元を行うとともに、業績に応じた弾力的な配当政策を行い、連結での配当性向35%を目安とする利益配分に関する基本方針に変更はありません。

最後に株主さまへメッセージをお願いいたします。

おかげさまで、当期は売上、利益、受注、受注残すべての面で過去最高の成績を達成することができました。今後はより一層成長スピードを加速させ、株主さまのご期待に応える所存です。

当社は、投資家の皆さまに投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大を図る目的から、2017年4月1日付けで1:2の株式分割を行いました。また前述の通り、今期からは中間配当を実施することで、株主さまへの利益還元の機会を増やします。これらの施策により当社の株式が、投資家さまや株主さまにとって今まで以上に親しみやすく身近な存在となることを切に願っております。

株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS「E120」を発売

技術五部 部長

宮井 博基



レーザーテックは、EUVマスクブランクの欠陥管理と歩留まりの向上に貢献する検査装置、EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICS「E120」を製品化したしました。

半導体デバイスの微細化を実現し、高性能化と低コスト化を進める次世代露光技術、EUVL (extreme ultraviolet lithography: 極端紫外線リソグラフィ) の実用化が始まるうとしています。

当社は以前からEUVLの検査技術に携わり、2011年から5年間、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による支援の下、(株)EUVL基盤開発センター(EIDEC)※と共同研究を進めてまいりました。検査に用いるEUV光(波長:13.5nm)は、大気中で減衰することから真空光学系が必要となります。また、EUV光は透過するレンズ材料が存在しないため、反射光学系を用いる必要があります。共同研究ではこれらの技術課題を解決し、EUV光による検査技術を確認いたしました。

2017年4月、この共同開発で得た技術を適用し、EUVL量産化実現に不可欠な検査装置EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICS「E120」を製品化しました。検査対象であるEUVマスクブランクスは、表面に80層

ABICS「E120」 開発の意義

共同研究により
EUV光による
検査技術を確立

EUVマスクブランクス
の欠陥管理と歩留まりの
向上に貢献

新中期経営計画
フェーズⅢにおける
新規事業の柱に

の多層膜からなる反射層を形成しています。マスクブランクス
の製作工程で多層膜内部に微粒子などが入ると、露光
に影響を及ぼす位相欠陥となるため、それらの欠陥を無く
すことは重要課題となっていました。

本製品の特長として、Actinic 検査（露光装置と同じ波長
の光を用いる検査）と暗視野検査を実現したことが挙げ
られます。検査にも露光と同じ波長のEUV光を用いる
ことで、転写性欠陥を検出することができるようになり
ました。また、暗視野検査では高感度かつ高速な検査を
実現しました。これらの性能は、EUV用マスクブランクス
の欠陥管理や歩留まり向上に大きく貢献します。

新中期経営計画フェーズⅢ（2018年7月～2021年6月）
では、コアビジネスと新規事業の2分野を軸に、EUVL 関連

装置を新規事業の柱とし売上を伸ばしてまいります。

必要な検査技術を必要なタイミングで確立し、EUVL 量
産化に貢献していくとともに、ABICSの開発で得られた技
術を他の装置に展開していくことで、さまざまなお客さま
のニーズにお応えしていきたいと考えています。

※ 現社名（株）先端ナノプロセス基盤開発センター（コンソーシアム企業）
（株）EUVL 基盤開発センターは共同研究当時の社名

用語解説

● リソグラフィ

半導体デバイスの微細で複雑な回路パターンを、露光装置
を介してウエハ上に転写する技術

● マスクブランクス

回路パターンが描かれる前の基板

レーザーテックを取り巻くマーケット・トレンドと 受注・売上を牽引する製品をご紹介します。

これまで半導体需要の大半を占めていたPCとスマートフォンに加え、IoT(さまざまなモノがインターネットとつながる)、AI(人工知能)の進展、自動車の自動運転化の分野で半導体の増加が見込まれています。

また膨大な量のデータを保存するデータセンターで使われる半導体や、スマートフォン、自動車などに搭載されるイメージセンサの使用量も増加していきます。

これらの市場動向から当社製品では、マスク欠陥検査装

置MATRICS、マスクブランク欠陥検査装置MAGICS、SiCウェハ欠陥検査/レビュー装置SICAが伸びていきます。

一方FPD関連においては、テレビ用大型パネルの供給不足により投資が加速されることや、スマートフォンに採用される有機ELが増えることから、ディスプレイ業界の見通しは明るく、これに伴い、当社のFPDフォトマスク欠陥検査装置CLIOSの需要が高まる見込みです。



Mobile / IoT

さまざまなモノが
ネットにつながるIoT



Data Center

膨大な量のデータ保存



AI

人工知能の実現



Automotive

車の電気・電子化、
自動運転の実現

4分野の拡大により、需要が増えるもの

- 計算や画像処理を行う「ロジックデバイス」
- データを記憶する「メモリー」
- 光を感知し画像を作る「イメージセンサ」
- 高効率で高精細に表示する「有機EL」
- 電力変換の省エネに貢献する「SiC」

ニーズが高まるレーザーテックの検査装置

〈半導体関連:ロジック、メモリー、イメージセンサ〉



MATRICS



MAGICS

〈半導体関連:SiC〉



SICA

〈高精細FPD関連:大型パネル、有機EL〉



CLIOS

Topic 1 中国上海市に現地法人設立 (2017年6月7日)

当社100%子会社であるLasertec Taiwan, Inc.の全額出資による現地法人Lasertec China Co., Ltd.を中国上海市に設立しました。

今後、大きな成長が見込まれている中国市場での当社製品の技術支援を目的とし、納入から立上げ、保守、

サポート業務を行います。

以前から中国顧客と緊密な関係を持つLasertec Taiwan, Inc.の実績を生かし、中国における支援体制を強化してまいります。

Topic 2 新製品発売：マスクブランクス欠陥検査装置 MAGICSシリーズ「M8650/M8651」(2017年4月3日)

最先端半導体用マスクブランクス欠陥検査装置で、高感度・高スループット化に対応したMAGICSシリーズ最新機種を発売しました。

当社のマスクブランクス欠陥検査装置は長年にわたり高い評価と信頼をいただき、業界標準機としてマスクブランクスメーカーでの出荷検査、およびマスクメーカーやデバイスメーカーのマスク製造部署での受け入れ検査や、プロセス管理で活用されています。

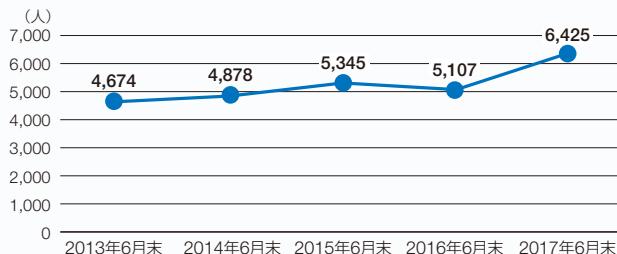
最先端の微細化プロセスに対応するため、マスク技術においてもEUVや新構造マスクの適用など、さまざまな技術革新が行われています。これに伴い、マスクブランクス検査に求められるさらなる高性能・高機能化のニーズにお応えし開発した製品です。すでに多くの引き合いをいただいております。複数台の受注が決定しています。



Topic 3 株主還元について

当社は業績に応じた弾力的な配当政策を行い、連結配当性向35%を目安とすることを利益配分に関する基本方針としております。より投資しやすい環境にするため、2017年4月1日付で1:2の株式分割を行い、投資家層の拡大を図りました。また、利益還元の機会を充実させるため、今期(2018年6月期)より、今までの期末配当1回から中間と期末の年2回配当する方針に変更いたしました。

株主数の推移



2017年6月期(第55期)の連結決算のご報告

連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (2017年6月30日)	前連結会計年度 (2016年6月30日)	科目	当連結会計年度 (2017年6月30日)	前連結会計年度 (2016年6月30日)
資産の部			負債の部		
流動資産	25,439	18,799	流動負債	8,328	3,839
			固定負債	210	222
固定資産	7,579	7,070	負債合計	8,539	4,061
			純資産の部		
資産合計	33,019	25,870	株主資本	24,243	21,839
			① 純資産合計	24,479	21,808
			負債純資産合計	33,019	25,870

連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2016年7月1日 至2017年6月30日)	前連結会計年度 (自2015年7月1日 至2016年6月30日)
② 売上高	17,369	15,291
売上原価	7,814	6,403
売上総利益	9,554	8,887
販売費及び一般管理費	4,593	4,459
③ 営業利益	4,960	4,428
③ 経常利益	4,989	4,575
③ 親会社株主に帰属する当期純利益	3,554	3,227

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2016年7月1日 至2017年6月30日)	前連結会計年度 (自2015年7月1日 至2016年6月30日)
④ 営業活動による キャッシュ・フロー	3,549	3,083
投資活動による キャッシュ・フロー	△618	△368
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,151	△1,038
現金及び現金同等物の 期首残高	7,967	6,537
現金及び現金同等物の 期末残高	9,736	7,967

決算のポイント

① 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は、244億79百万円となりました。また自己資本比率は74.1%で、引き続き財務の健全性を維持しています。またROE(自己資本当期純利益率)は15.4%、ROA(総資産当期純利益率)は12.1%となりました。

② 売上高

半導体マスク欠陥検査装置が好調で、半導体関連装置の売上が120億円を超え、過去最高額を達成しました。

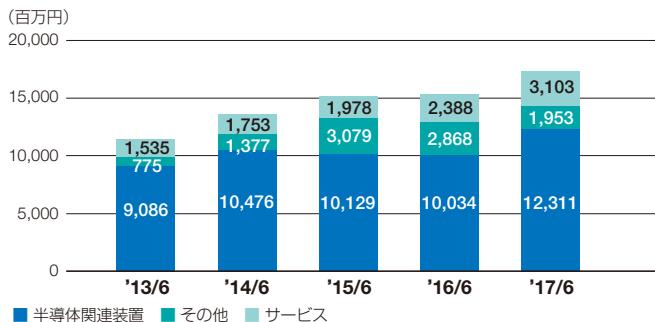
③ 利益

営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益も過去最高益を達成しました。

④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

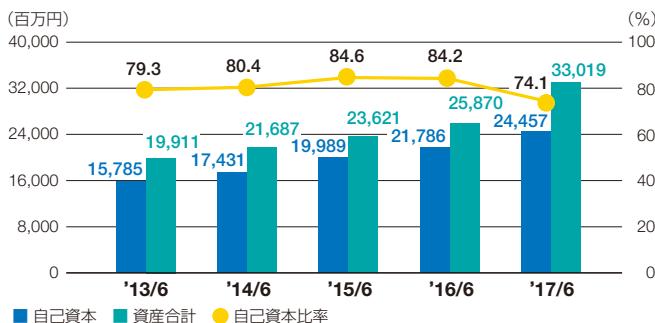
税金等調整前当期純利益、前受金の増加などの収入要因が、たな卸資産の増加、売上債権の増加などの支出要因を上回りました。

製品別売上高

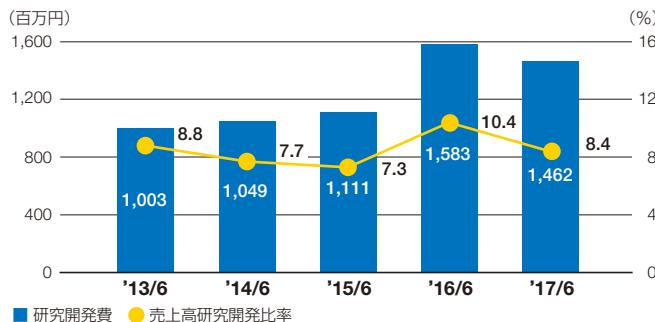


※2014年6月期より、従来のFPD関連装置およびレーザー顕微鏡の売上高は、その他とすることに変更し、2013年6月期の製品別売上高も遡及修正しています。

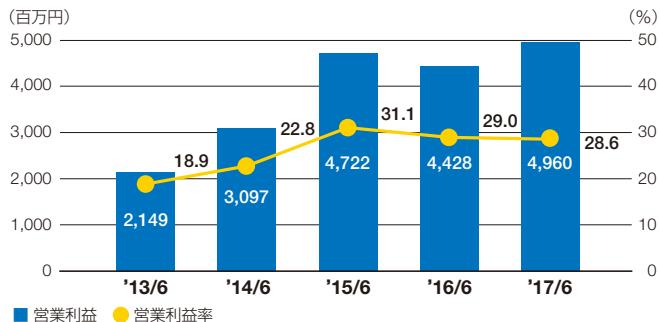
自己資本・資産合計・自己資本比率



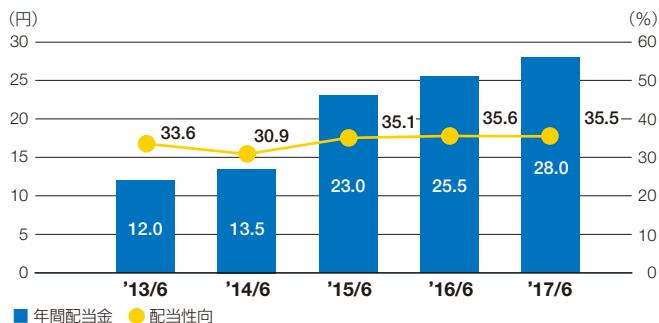
研究開発費・売上高研究開発比率



営業利益・営業利益率

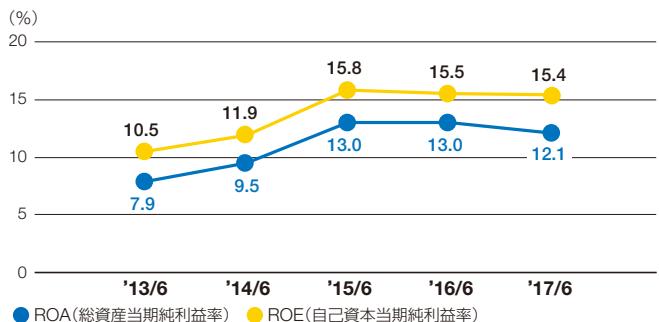


年間配当金・配当性向



※2013年7月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施し、2017年4月1日付けで、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を再度行いました。そのため、2013年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、上記の金額を算定しています。

ROA・ROE



会社概要 (2017年6月30日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 288名 単体 208名

株式情報 (2017年6月30日現在)

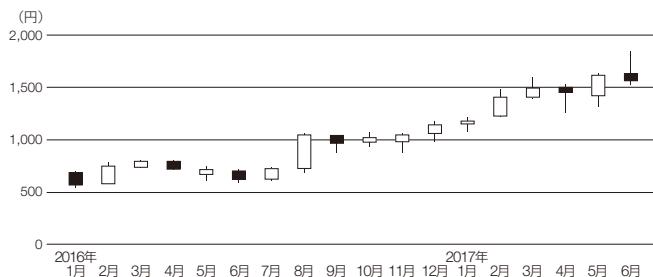
株式概要

上場市場	東京証券取引所市場第一部
発行済株式総数	47,143,200株
株主数	6,425名
大株主一覧	

	所有株式数(株)	持株比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,506,500	5.31
内山 靖子	2,003,200	4.24
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,943,000	4.12
内山 洋	1,741,600	3.69
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,504,000	3.19
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,446,800	3.06
内山 秀	1,394,000	2.95
前田 せつ子	1,293,600	2.74
BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND	1,259,000	2.67
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	829,000	1.75

(注)上記のほか、当社は発行済株式総数に対し、4.35%の自己株式を保有しています。

株価の推移



(注)当社は2017年4月1日付けで、普通株式1株を2株に分割いたしました。
上記グラフは、2016年1月から当株式分割が行われたと仮定して算出した株価の推移です。

役員 (2017年9月27日現在)

代表取締役社長 岡林 理	社外取締役 梶川 信宏 海老原 稔 下山 隆之
代表取締役副社長 楠瀬 治彦	常勤監査役 塚崎 健明
常務取締役 内山 秀	監査役 古賀 一正 齋藤 侑二 石黒 美幸
取締役 森泉 幸一 関 寛和	

株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)

単元株式数	100株
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <http://www.lasertec.co.jp>
ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いさせていただきます。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本店でお支払いいたします。

当社Webサイトのご案内

<http://www.lasertec.co.jp>

2016年12月、Webサイトをリニューアルしました。IR情報をさらに充実させ、スマートフォン対応サイトも開設しました。ぜひご覧ください。

企業ホームページ
優秀サイト
2016
日経アワード
総合ランキング

